

令和8年2月26日

関係各位

(一社) 日本実装技術振興協会  
会長 嶋田 勇三

## 第237 定例講演会のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、日本実装技術振興協会の第237 回定例講演会の内容が決まりましたのでお知らせいたします。

今回は会場とWEB会議システム（Zoom ウェビナー）を利用したハイブリッド開催となります。

ご多忙の中恐縮ではございますが、万障お繰り合わせの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。ホームページでも同定例講演会の情報を配信します。

敬具

### 記

1. 開催日時：令和8年3月19日（木）定例講演会 12：50～16：50  
技術交流会 17：00～18：00

2. 開催方式：ハイブリッド方式

【川崎市産業振興会館第3研修室+WEB会議システム「Zoom ウェビナー」】

（Zoom参加を申し込みされた方には後日、招待メールをお送りします）

川崎市産業振興会館：神奈川県川崎市幸区堀川町66番地20

<https://kawasaki-sanshinkaikan.jp/>

3. プログラム：“Chiplet, AI/IoT時代の先端半導体実装技術  
（長野実装フォーラム特集）”

(1) 12:50～13:30 プログラムテーマ①	『長野実装フォーラムの活動』 コネクテックジャパン(株) 監査役/長野大学 理事 若林 信一 氏 講演内容：長野実装フォーラムの設立の経緯からこれまでの活動を紹介します。また、過去の実装技術の展開を振り返り、これからの実装技術開発の努力が集中される領域とその必然性について述べる。
(2) 13:30～14:20 プログラムテーマ②	『未来を創る最先端半導体パッケージング技術』 新光電気工業(株) 執行役員 開発統括部長 荒木 康 氏 講演内容：最先端の半導体技術開発現場では、バックエンドプロセス(後工程)の進化が必要不可欠であり、特に「先端半導体パッケージング技術」は、半導体の高性能、多機能化への要求に応え、高集積化が進んでいる。本講演では、それら技術の進化と要求特性の両立を実現する半導体パッケージ基板技術と有機インターポーザー技術、ガラス基板技術、光電融合パッケージについて紹介する。
(3) 14:20～15:10 プログラムテーマ③	『チップレット実装の未来をひらく“受託開発・受託製造”一貫ビジネスモデル 「CADN (キャダン：Chiplet Ameba Development Network)」』 コネクテックジャパン(株) 代表取締役会長 平田 勝則 氏 講演内容：年間約400件の実装受託開発・製造を通じて見えてきた最先端チップレットパッケージにおける各種各様の実装課題と市場要望を解決し「あなたのしたいをできたに変える」新ビジネスモデル「CADN」を展開。同社の取り組み概要、開発事例を紹介する。
15:10～15:20	－ 休憩 －
(4) 15:20～16:00 プログラムテーマ④	『IoT向け低消費電力 RISC-V SoC 研究開発』 セイコーエプソン(株) 技術開発本部 デバイス技術開発部 部長 寺島 真秀 氏 講演内容：IoT、AI、ロボット、車載等のアプリケーション需要が急速に拡大する中、ネットワークやクラウドに集約される膨大なデータ処理をエッジ側で効率的に実行する技術が求められている。本研究では、ライセンスフリー命令セットである RISC-V アーキテクチャとハードウェアアクセラレータを組み合わせたシステム構成を提案し、高効率な演算処理を実現するとともに、国内産業における RISC-V ベース製品開発の活性化に貢献する。

<p>(5) 16:00～16:30 プログラムテーマ⑤</p>	<p>『信州半導体高度専門人材育成コンソーシアムの紹介』 信州大学 学術研究院工学系 教授 宮地 幸祐 氏 講演内容：2026年度4月より信州大学は工学部を中心として信州半導体高度専門人材育成コンソーシアムを発足させる。産学官で連携し、学生および社会人向けに講義や実習を産学で相互に提供しあい、不足する高度専門半導体技術者の育成を目指す取り組みである。本講演では、信州大学として目指す半導体研究教育体制を示すとともに、コンソーシアムの概要と活動内容について紹介する。</p>
<p>(6) 16:30～16:50 会社紹介</p>	<p>『ガラスサブストレートをリーズナブル、フレキシブルに提供する晶孔技研』 (株)晶孔技研 代表取締役社長 程 茹秋 氏 講演内容：同社が提供するガラスサブストレートおよび TGV ガラスインターポーザー技術を紹介する。低コスト・短納期を実現しながら、最小 30μm の穴加工、各種メタライゼーション、RDL 形成、CMP など多様なプロセスに柔軟対応可能である点が特長である。さらに、設計調整から試作、実装、評価まで一貫して支援し、光導波路インターポーザーを含む先端デバイス開発を力強くサポートする。将来のパートナーとして、お客様の研究開発と事業化を加速させるソリューションを提案する。</p>
<p>17:00～18:00</p>	<p>－ 技術交流会 － 産業振興会館 2階「カフェサウダージ」にて</p>

#### 4. 参加費

会 員：無料 企業正会員は1社3名まで (Web 会議特例：3名を超える参加者については事務局にお問い合わせください)。また、同じ名前とメールアドレスで複数人の方が入室した場合、システム上、同一人物が入室した人数分表示されます。1登録1名様のご利用でお申込みください。  
会員外：22000円/人 (不課税) (お申し込み後、請求書をお送りします)

#### 5. 参加申し込み

会 員：会員は別途メールでお送りしているご出欠連絡用紙 (企業正会員には登録代表者 (連絡担当者) にお送りしています) にご記入の上、E-mail にてお申し込みいただけますようお願いいたします。

※今回、会場と Zoom ウェビナーのハイブリッド方式での開催となります。お申し込みの際は、参加者それぞれ、どちらの方式での参加をご希望か記載してください。

会員外：ホームページのお問い合わせフォーム (<https://www.j-jisso.org/p/contact.html>) より「お問い合わせ内容」の項目に「第 237 回定例講演会参加希望」と参加方式 (会場もしくは Zoom) をご記載下さい。参加申込者と参加者が異なる場合、参加者のお名前と E-mail アドレスもご記入ください。お申し込み後、折り返しご連絡をいたします。

申込締切日：会 員 令和 8 年 3 月 10 日 (火)

会員外 令和 8 年 3 月 10 日 (火)

※講演 2 日前までに、ご参加者各人に招待メールをお送りしますので、ご参加者全員の氏名・メールアドレスをご連絡ください。また、Zoom ウェビナーに参加される際には、ご連絡いただきましたメールアドレス・参加者氏名でログインするようにお願いいたします。セキュリティの関係上、名簿と合致しない場合、Zoom 定例講演会から退場していただく場合がございます。参加者が変更する場合はご連絡ください。

※今年度から講演資料は、当会ホームページの会員のページ (<https://www.j-jisso.org/member/>) に講演日までにアップいたします。ID と PW が必要ですので講演日前までにご確認ください (企業正会員は貴社連絡担当者にご確認下さい)。今年度より資料の郵送はいたしません。

会員外の方はクラウドで資料共有をいたします。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さいませようお願い致します。

事務局：一般社団法人 日本実装技術振興協会 事務局

URL：<http://www.j-jisso.org> (HP 右上の「お問い合わせ」からご連絡下さい)